**各位 お問い合わせ先**

マット・バーンズ（Matt Burns）

 matthew.burns@samtec.com

 812-944-6733

**[SAMTEC LOGO] 2017年9月**

**Samtec社、ExaMAX®高速バックプレーン コネクタシステムを拡充、
新たに直交型ダイレクト嵌合（DMO）タイプを追加**

直交型アーキテクチャによりシグナルインテグリティ性能と熱効率が向上

**インディアナ州ニューアルバニー：** Samtec, Inc.（Samtec社）は、電子インターコネクト ソリューションの広範な製品群を有する世界的メーカーです。非上場ながら、年間売上高は6億6,200万ドルに上ります。Samtec社は、このたび、ExaMAX® 高速バックプレーンコネクタシステムを拡充し、新たに直交型ダイレクト嵌合（DMO）タイプを発表しました。従来のバックプレーンシステムに比べて、直交型ダイレクト嵌合アーキテクチャ固有の長所を活かしたシステム設計が可能となります。

Samtec社の新しいExaMAX® DMOソリューションは、ミッドプレーンをなくすことにより、システム設計の自由度を拡大し、ファブリックカードとラインカードの直接嵌合を可能にします。この急速に広まりつつあるシステムアーキテクチャでは、エアフローが増加し、筐体全体の熱効率が改善します。DMOソリューションは、システムBOMの合理化とシステムコストの最適化とともに、トレース長の短縮と、より少ないコネクタでの伝送によりシグナルインテグリティの向上を実現します。

Samtec社のExaMAX® DMOシステムは、既存の[EBTF-RA](https://www.samtec.com/products/ebtf-ra) シリーズと直接嵌合する新シリーズである[EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra)シリーズです。現在、6ペアｘ10列および6ペアｘ12列の2種類のソリューションを提供しています。ガイドピンおよびねじ止めタイプもございます。6ペアｘ6列および6ペアｘ8列のタイプは、現在開発中です。

Samtec社のバックプレーンプロダクトマネージャのジョナサン・スプリグラー（Jonathan Sprigler）は、次のように述べています。「次世代システム設計者によるDMOアーキテクチャの採用が進んでいます。ストレージ、サーバ、ネットワーキング等のアプリケーションを含めて、データセンタ業界全体において、主要な機器サプライヤが、当社の新製品EBDM-RAシリーズの長所を活かしています。」

Samtec社の[EBDM-RA](https://www.samtec.com/products/ebdm-ra) シリーズは、ExaMAX®高速バックプレーン コネクタシステムのソリューションの一つに過ぎません。ExaMAX®製品群は、最高速度56 Gbps（パルス振幅変調PAM-4）に最適化されています。反射損失コンプライアンスは、92 Ω仕様を目指しており、コネクタ内のすべての幾何学的移行で反射制御を行うため、85 Ω と100 Ω の両システムに対応しています。

ExaMAX®は、優れたコンタクト接圧と業界最小の挿抜力を誇り、Telcordia GR-1217 CORE 仕様に適合しています。角度のある嵌合の場合でも、信頼性の高いコンタクトポイントが常に2点あり、シグナルインテグリティ性能向上のため、スタブを最小化しています。オス/メスの区別がない（雌雄同型）嵌合インターフェースにより、スタブなし嵌合と信頼性の高い位置合わせを実現するとともに、2.4 mm の有効嵌合長が信頼性を向上しています。

バックプレーンシステムは、スキューのない列に配列され、千鳥デザインの差動ペアを備えた個別の信号ウェハを有しています。各ウェハは、グランド一体成型の構造を持っており、絶縁性を向上することでクロストークを大幅に削減します。

詳細は、「[High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond](http://www.eejournal.com/chalk_talks/high-speed-backplane-connectors-drive-56-gbps-and-beyond/)*（高速バックプレーンコネクタ、56 Gbps超に対応）*」のウェビナーをご覧ください。また、[ExaMAX® High-Speed Backplane Connector System](https://www.samtec.com/connectors/backplane/high-speed-backplane-systems/examax)（ExaMAX®高速バックプレーンコネクタシステム）のランディングページをご覧下さい。設計ガイドは、「[High-Speed Board-to-Board Application Design Guide](http://suddendocs.samtec.com/literature/samtec-high-speed-b2b-design-guide.pdf)（高速ボード・ツー・ボード アプリケーション設計ガイド）」をダウンロードしてください。Samtec社バックプレーンアプリケーションの専門家による即時技術サポートは、HSBP@samtec.comからご利用可能です。

**Samtec, Inc.について**1976年創業のSamtec社は、非上場企業で、年間売上高は6億6,200万ドルに上ります。ICとボード間およびICパッケージ、高速ボード・ツー・ボード、高速ケーブル、ミッドボードおよびパネル・オプティクス、フレキシブル・スタッキング、ならびに小型/堅牢部品およびケーブル等、幅広い電子インターコネクト ソリューションの製品を有する、世界的な製造業者です。Samtec テクノロジー・センターは、ベアダイから距離100メートルのインターフェースまでのシステムおよびその間のあらゆるインターコネクトポイントに関して、性能・コスト共に最適化するための、技術、戦略および製品の開発・高度化に注力しています。18カ国、33箇所の拠点における、Samtec社の世界的なサポート体制が比類なき顧客サービスの提供を可能としています。より詳しい情報は、Samtec社ウェブサイトをご覧ください（<http://www.samtec.com>）。

ExaMAX®は、Amphenol Corporation（**アンフェノール**社）の登録商標です。

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**電話: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

[www.samtec.com](http://www.samtec.com)